

「先端加工フォーラム 2018」開催案内

主催：(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会 共催：金沢工業大学 FMT 研究所

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会では、「先端加工フォーラム 2018」を下記のとおり開催いたします。「研磨」をキーワードに産学官のそれぞれのお立場からの講演（特別講演 1 件，技術講演 4 件）を予定しております。近年脚光を浴びる難加工 SiC 基板の「超精密研磨」をはじめ、「アシスト応用研磨」の研究最前線とその実際を知る絶好の機会を作りましたので，拡大技術交流会を含め多数の皆さまのご参加をお待ちしています。

日 時：平成 30 年 5 月 11 日（金） 13：00～19：00

開催場所：金沢工業大学 21 号館 5 階会議室
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘 7-1 TEL：076-248-1100
URL：http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
[交通] 金沢駅兼六園口 8 番乗り場 → 「金沢工業大学行き」（所要時間：約 30 分）
金沢駅からタクシーで約 20 分

内 容：

13:00～13:05 開会挨拶

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会長 西田 均 (富山高等専門学校)

<特別講演>

13:05～13:55 SiC 半導体基板の加工技術 (総論)

国立研究開発法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター
招聘研究員 河田研治 氏

<技術講演>

13:55～14:40 電界砥粒制御技術を用いた工具刃先研磨加工とその効果

愛知工業大学 工学部 機械学科 教授 田中 浩 氏

14:40～15:00 休憩

15:00～15:45 高圧カプラズマを用いた SiC 基板の高エネルギー無歪加工

大阪大学 大学院工学研究科 准教授 佐野泰久 氏

15:45～16:30 先端結晶材加工の技術動向と取組 (仮題)

株式会社齊藤光学製作所 結晶事業部 事業部長 土田益広 氏

16:30～17:15 サブストレート加工への挑戦～研磨材料の需要拡大に向けて～

ニッタ・ハース株式会社 戦略マーケティング部 事業開発グループ マネージャー 羽場真一 氏

17:15～17:20 閉会挨拶

(公社)砥粒加工学会 副会長・北陸信越地区部会 事務局 諏訪部 仁 (金沢工業大学)

17:40～19:00 拡大技術交流会

参加費：講演会・・・一般 5,000 円，学生無料，拡大技術交流会・・・一般 3,000 円，学生 1,500 円。当日徴収致します。

参加申込締切：平成 30 年 4 月 20 日（金）

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 工学部 機械工学科 精密工学 (畝田) 研究室 竹澤瑛里子
TEL：076-248-1100 FAX：076-274-7072 E-mail：unc-asst@neptune.kanazawa-it.ac.jp

(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会「先端加工フォーラム 2018」参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		拡大技術交流会
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		
その他 連絡事項			

【上記項目をメール文面に直接書き込んで，お申し込みください】

→メール件名は「先端加工フォーラム 2018 参加申込書」としてください